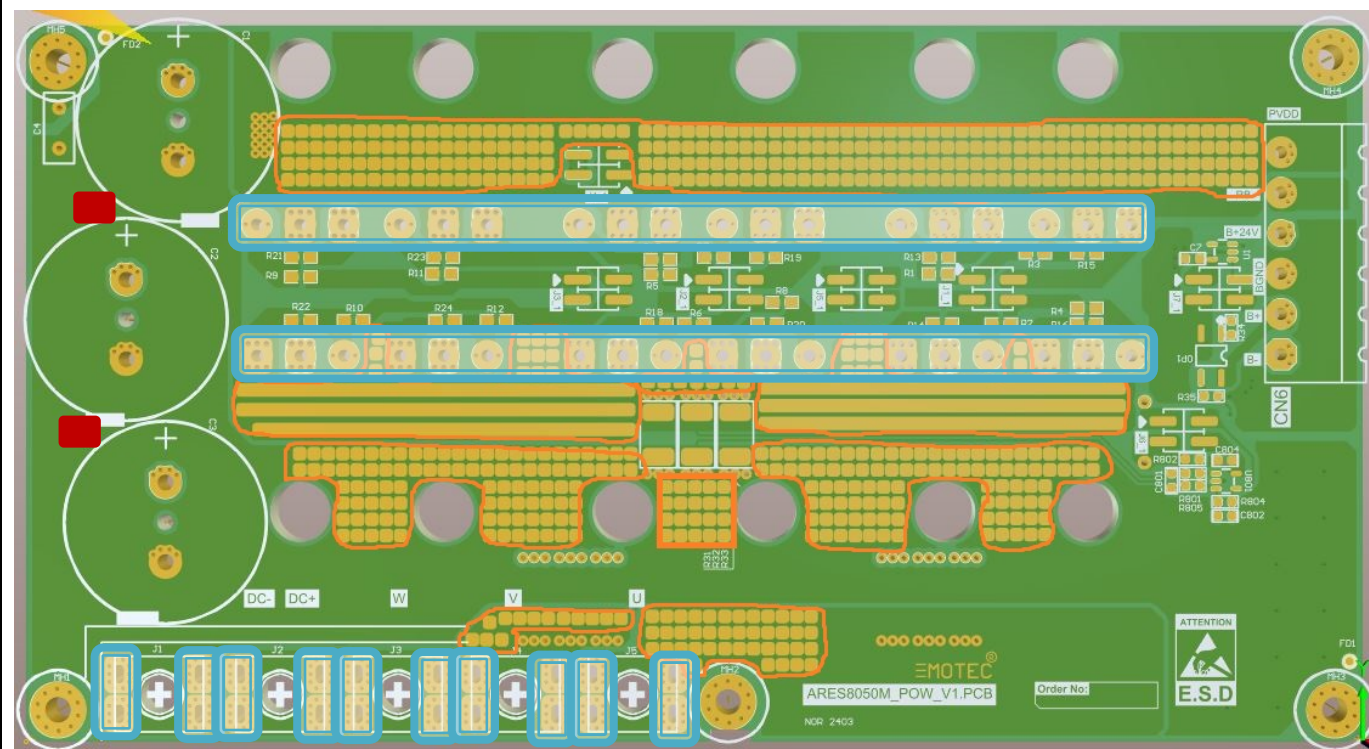


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8050M_POW_V1	焊接	QM03324032101	V1	1/2	20240321

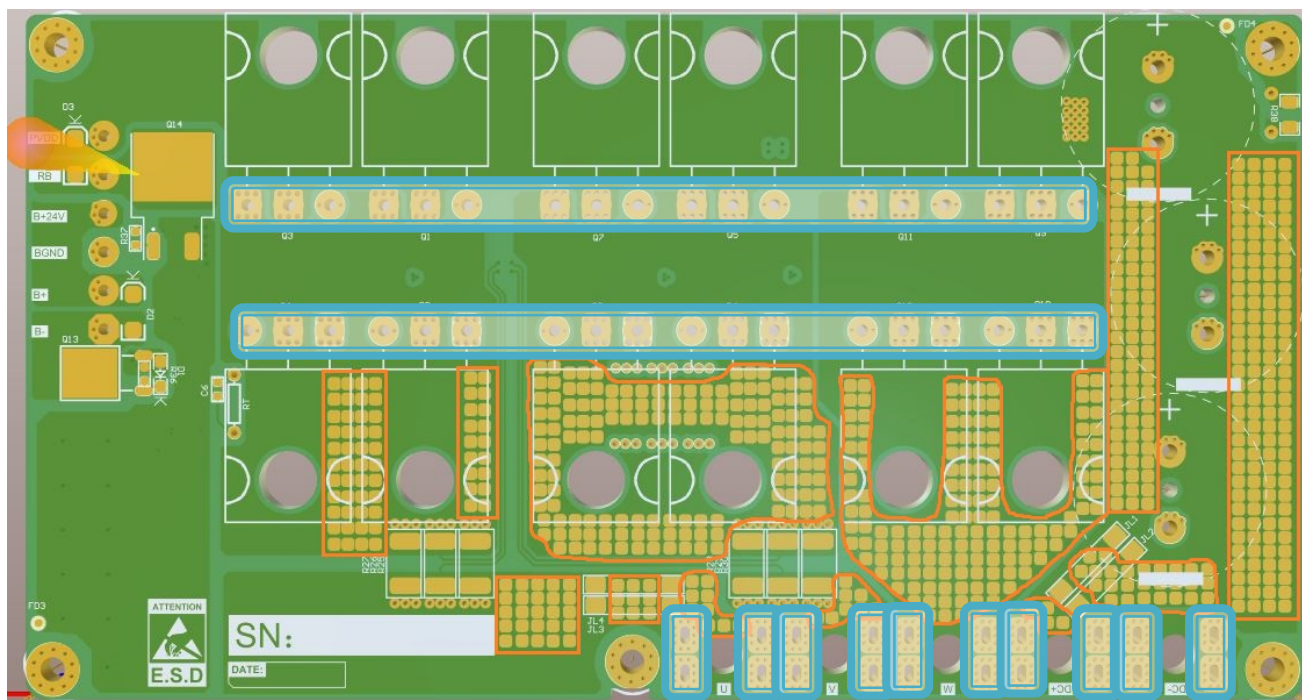
1. ARES8050M_POW_V1 加锡位置

顶层



- 1) 橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
- 2) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔注满焊锡，管脚上下焊接为锥面（锡量不要过多堆砌）；
- 3) 电解电容 C1~C3 位置处涂覆 704 黑色固定胶，点胶不要过量；



底层

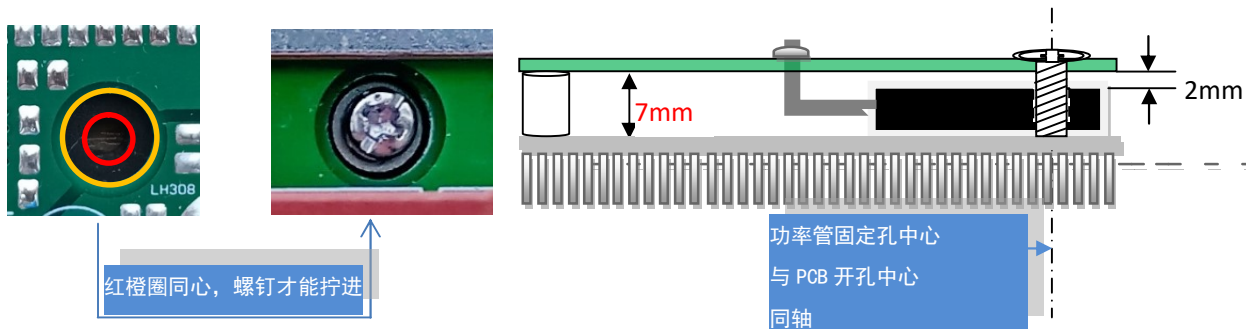


- 4) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔注满焊锡，管脚上下焊接为锥面（锡量不要过多堆砌）；
- 5) 橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm
- 6) J1~J5 端子，底层加锡焊接，焊锡熔化后，电烙铁仍要停留 2~3 秒，保证焊锡从过孔完全流到板子顶层。

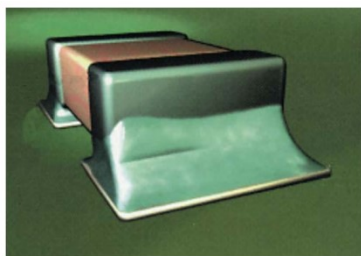
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8050M_POW_V1	焊接	QM03324032101	V1	2/2	20240321

2. 焊接基本要求

- 1) 功率管 Q1~Q12 共计 12 个 (T0-247 封装的管子)，管脚**直角折弯**，
- a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 **7mm** 焊接；且要求功率管脚顶层和底层**双面焊接**；
- b) 焊接后，功率管固定孔  红色圈中心与 PCB 开孔  橙色圈中心同轴；



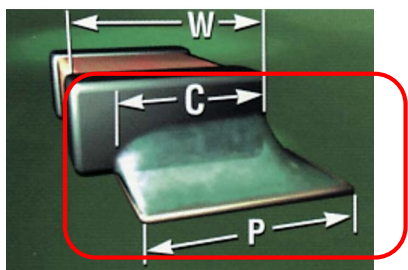
- 2) 电阻 R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33 要求焊接完成后，元件的电极与相应焊盘位置对正，即元件无移位



目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度，取两者中的较小者。

- 可接受:** a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm, 下图为焊接不良图片)。
- b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



备注：该位置要求 100%目检，不符合要求的，拒收

- 3) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 4) 所有极性元件，严禁方向反；
- 5) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 6) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 7) 手工操作要做防静电处理；
- 8) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 9) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	